

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会 备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次境外发行上市”）的相关工作。公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1134号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：

一、公司拟发行不超过 248,592,000 股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。

三、公司完成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

四、公司自备案通知书出具之日起 12 个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联

合交易所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026年5月23日